

TOWA (コード 6315)

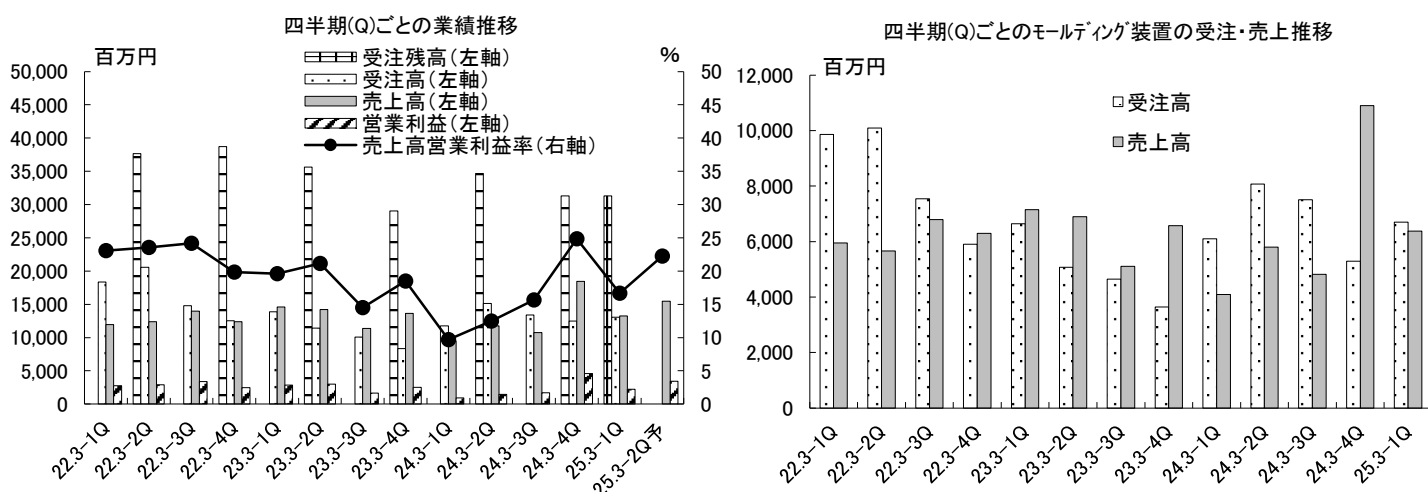
◆各決算期の第1四半期業績推移(連結) (株式分割を考慮。第1四半期のCFは非開示)

決算期	売上高	営業利益	1株純利益	1株配	営業CF	投資CF	財務CF	現金及び現金同等物
22.3	11,960	2,761	26.4	—	—	—	—	—
23.3	14,592	2,859	31.4	—	—	—	—	—
24.3	9,511	920	10.4	—	—	—	—	—
25.3	13,253	2,212	22.5	—	—	—	—	—

◆通期業績推移(連結) (25.3予は会社側発表値。株式分割を考慮)

決算期	売上高	営業利益	1株純利益	1株配	営業CF	投資CF	財務CF	現金及び現金同等物
22.3	50,666	11,505	108.4	16.7	6,403	▲6,600	1,925	12,250
23.3	53,822	10,037	97.9	13.3	2,831	▲2,746	3,962	16,430
24.3	50,471	8,661	85.9	13.3	9,665	▲2,773	▲3,524	20,517
25.3予	60,000	12,600	117.7	20.0	—	—	—	—

(CF=キャッシュ・フロー。現金及び現金同等物は各期末値。▲はマイナス。単位は百万円、円)



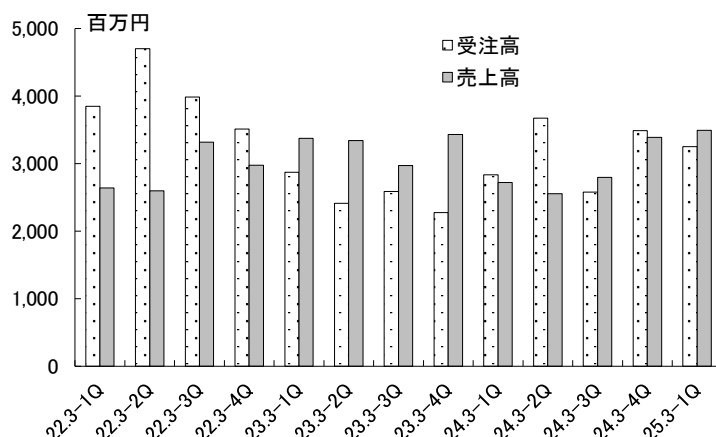
25年3月期第1四半期の業績概況…25年3月期第1四半期(24年4~6月)は、生成AI関連向けや通信デバイス関連向けを中心に、同社独自のコンプレッション装置・金型の受注、売上が引き続き高水準で推移しており、モルディング装置・金型の売上が増加。顧客の稼働率改善に伴ってTSS(トータル・ソリューション・サービス)の売上也拡大したことから、売上高は前年同期に比べ39%、営業利益は140%それぞれ増加した。

当期の業績は、売上高132億5,300万円(前年同期比39.3%増)、営業利益22億1,200万円(同140.3%増)、経常利益24億2,000万円(同112.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益16億9,000万円(同115.9%増)となった。

セグメント別の売上高は、半導体製造装置事業122億5,800万円(前年同期比43.6%増)、化成品(ファインプラスチック成形品)事業5億6,900万円(同3.8%増)、レーザ加工装置事業4億2,400万円(同0.2%減)で、半導体製造装置事業のうち、半導体製造用等精密金型34億9,100万円(同28.4%増)、モルディング装置63億7,400万円(同55.8%増)、新事業(TSSなど)21億9,800万円(同52.7%増)など。また、セグメント別の営業利益では、半導体製造装置事業が21億6,400万円(同172.2%増)と大きく伸びた一方、化成品事業1億2,600万円(同5.8%減)、レーザ加工装置事業7,800万円の損失(前年同期は800万円の損失)となった。

当期の受注高は130億7,500万円(同11.3%増)に伸び、受注残高も24年3月期末並みの313億1,000万円と高水準を維持している。セグメント別の受注高については、半導体製造装置事業120億7,100万円(同13.8%増)、化成品事業5億5,000万円(同0.2%減)、レーザ加工装置事業4億5,200万円(同21.7%減)で、半導体製造装置事業のうち、半導体製造用等精密金型32億5,100万円(同14.7%増)、モールドイング装置66億9,800万円(同9.8%増)、新事業23億9,600万円(同54.2%増)など。このうち、コンプレッション装置の受注(金型込み)は55億7,200万円(同91.3%増)に急拡大している。

四半期(Q)ごとの半導体製造用等精密金型の受注・売上推移

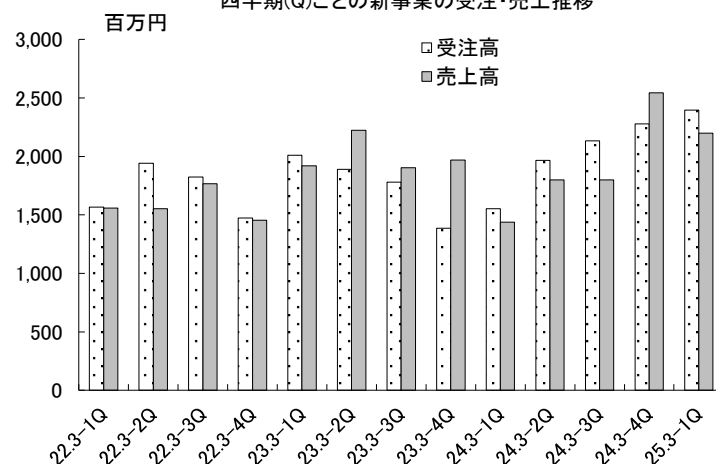


生成AIの急速な普及に伴うサーバー向けHBM(超広帯域メモリ)の需要拡大や中国における半導体内製化への設備投資の増加に加え、台湾での設備投資が持ち直しつつあることなどを背景に、主力の半導体製造装置事業が受注高、売上高、営業利益ともに伸長。引き続き、同社の業績拡大の原動力となっている。

25年3月期の通期業績見通し…25年3月

期の通期業績は24年5月10日付けの会社側発表値から変更は無く、受注高600億円(前期比13.8%増)、売上高600億円(同18.9%増)、営業利益126億円(同45.5%増)、経常利益126億円(同38.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益88億3,000万円(同37.0%増)の見通し。

四半期(Q)ごとの新事業の受注・売上推移



セグメント別売上高予想では、半導体製造装置事業547億円(同19.2%増)、化成品事業22億円(同2.3%増)、レーザ加工装置事業31億円(同28.3%増)で、半導体製造装置事業のうち、半導体製造用等精密金型121億円(同5.6%増)、モールドイング装置287億円(同12.1%増)、新事業104億円(同37.2%増)など。また、受注高予想では、半導体製造装置事業549億円(同13.7%増)、化成品事業22億円(同2.0%増)、レーザ加工装置29億円(同28.1%増)で、半導体製造装置事業のうち、半導体製造用等精密金型124億円(同1.4%減)、モールドイング装置293億円(同8.6%増)、新事業104億円(同31.1%増)などとなっている。

なお、同社では24年9月末を基準日として1株につき3株の株式分割を実施。株式分割後の今期予想1株当たり配当金は20円(期初計画通り。分割前の換算では60円)となる。

本レポートは、会社側が発表した決算短信や決算説明資料などに基づき作成しており、証券投資の参考となる情報の提供を目的としたもので、証券の売買を勧誘する目的で作成したものではありません。株式の売買取引には、約定代金に対して手数料が必要となります。また、株式は、株価の変動により損失が生じる恐れがあります。投資に関する最終決定は、投資家ご自身の判断でなさいますようお願い致します。本レポートは各種データに基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありませんので、予めご了承下さい。なお、本レポートの著作権は西村証券に帰属しており、電子的・機械的などの方法を問わず、無断で本レポートを引用または複製、転送することを禁じます。